

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850-steel-legend-wifi-am5-4ddr5-atx-p-349935.html>



## Płyta główna B850 Steel Legend WiFi AM5 4DDR5 ATX

Cena brutto	<b>839,99 zł</b>
Cena netto	<b>682,92 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBASRAA8B850A02</b>
Kod producenta	<b>B850 STEEL LEGEND WIFI</b>
Kod EAN	<b>4711581490062</b>
Wymiary	<b>30.5 cm x 24.4 cm</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>256</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 11</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
RAID	<b>Tak</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>11</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>8000 MHz</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x PCIe 4.0 x 16</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Interfejs sieciowy	<b>LAN 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User</b>
Maksymalna ilość urządzeń ATA	<b>4</b>
Bios	<b>256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support</b>
Format płyty	<b>ATX</b>
Karta dźwiękowa	<b>7.1 CH HD Audio z ochroną treści (kodek audio Realtek ALC4082) Oddzielne warstwy PCB dla kanału audio R/L Technologia Direct Drive na przednim porcie słuchawkowym (obsługuje zestawy słuchawkowe do 600 Ohm) Nahimic Audio</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>7</b>
Akcesoria w zestawie	<b>2 x Kabel danych SATA 2 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz</b>

	<b>Kabel rozdzielający ARGB Kabel termistora</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Nie</b>
Chipset	<b>AMD B850</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>9</b>
Złącza zewnętrzne	<b>3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A</b>
Producent chipsetu MB	<b>AMD</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR5</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>1 x Złącze przewodu termistora</b>
Oprogramowanie	<b>Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash</b>
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	<b>5</b>
Liczba gniazd DDR5	<b>4</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>CPU:- 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*Chipset:- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2230/2260/2280</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Grafika	<b>Zintegrowana karta graficzna AMD RDNA (rzeczywiste wsparcie może się różnić w zależności od procesora)- 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatybilny, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i maks. rozdzielczość do 4K 120 Hz</b>
Rodzina procesora	<b>AMD Ryzen 5</b>

## Opis produktu

### B850 Steel Legend WiFi

Steel Legend reprezentuje filozoficzny stan solidnej jak skała trwałości i nieodpartej estetyki. Zbudowana wokół najbardziej wymagających specyfikacji i funkcji, seria Steel Legend jest skierowana do codziennych użytkowników i entuzjastów głównego nurtu! Zapewniając solidny zestaw materiałów/komponentów, aby zapewnić stabilną i niezawodną wydajność.

### Ekskluzywny kondensator 20K o pojemności 1000uF

Ulepszony czarny kondensator 20K nie tylko wydłuża żywotność do 20 000 godzin, ale także zwiększa wartość pojemności z 560uF do 1000uF, co przynosi kilka korzyści:

- Większa pojemność: Większe magazynowanie ładunku dla lepszego wsparcia przy dużych obciążeniach.
- Niższe tętnienie: Zmniejszone wahania mocy wyjściowej, poprawa jakości.
- Bardziej stabilny prąd wyjściowy: Stabilne zasilanie, minimalizujące wpływ napięcia.
- Lepsza wydajność i stabilność systemu: Zwiększona niezawodność i stała wydajność.

---

## **14+2+1 Power Phase Design**

Wyposażony w solidne komponenty i całkowicie płynne dostarczanie mocy do procesora. Ponadto oferuje niezrównane możliwości podkręcania i zwiększoną wydajność przy najniższej temperaturze, co jest również przydatne dla zaawansowanych graczy.

## **Dr. MOS**

Dr.MOS to zintegrowane rozwiązanie stopnia mocy, które jest zoptymalizowane pod kątem synchronicznych zastosowań obniżających napięcie buck-set! W porównaniu do tradycyjnych dyskretnych tranzystorów MOSFET inteligentnie dostarcza wyższy prąd dla każdej fazy, zapewniając tym samym lepszy wynik termiczny i lepszą wydajność.

## **Złącze zasilania Hi-Density**

Podkręcanie procesora wymaga wyższego prądu. Złącza zasilania ASRock Hi-Density są zaprojektowane tak, aby wytrzymywać wyższe prądy w porównaniu do tradycyjnych złączy zasilania procesora i ATX, zapewniając bardziej stabilny system i zmniejszając ryzyko pożaru podczas intensywnego podkręcania.

## **Konstrukcja płytki PCB 8-warstwowej**

Płytki PCB 8-warstwowa zapewnia stabilne ścieżki sygnału i kształty mocy, zapewniając niższą temperaturę i wyższą efektywność energetyczną, gwarantuje niezawodny i trwały system, zapewniając jednocześnie najwyższą wydajność bez żadnych kompromisów.

## **Obsługa DDR5 XMP i EXPO**

Wywodząca się z koncepcji projektowania zbudowanego dla stabilności i niezawodności, ASRock nie idzie na żadne kompromisy w kwestii szczegółów. Ta płyta główna jest zbudowana z wysokiej jakości materiałów, entuzjaści mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością podkręcania pamięci DDR5, włączając wstępnie przetestowane profile. Upewnij się, że moduły pamięci są zgodne z Intel XMP/AMD EXPO, a podkręcanie może być tak niedrogie, satysfakcjonujące i absolutnie bezproblemowe.

## **Złącze USB 3.2 Gen2x2 Type-C na przednim panelu**

Najnowszy interfejs USB 3.2 Gen2x2 Type-C zapewnia prędkość przesyłu danych do 20 Gb/s, czyli dwa razy szybciej niż poprzednia generacja, zapewniając błyskawicznie szybki interfejs przesyłu danych z odwracalną konstrukcją USB Type-C, która pasuje do złącza w obie strony.